

2021年中国半导体硅片市场分析报告- 产业运营现状与发展潜力评估

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2021年中国半导体硅片市场分析报告-产业运营现状与发展潜力评估》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/545390545390.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

近年来在政府的高度重视和大力扶持之下，我国的半导体产业快速发展，产业链的各个环节都得到了长足的进步。2020年7月，国务院出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（国发[2020]8号），从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面提出37条具体政策措施，进一步加大力度支持集成电路和软件产业发展。

而伴随着国家政策的大力支持和全球芯片制造产能向中国大陆转移，我国半导体硅片企业技术水平和市场份额将会快速提升。

1、行业主管部门及监管体制

半导体硅片行业的主管部门为工信部，行业自律组织为中国半导体行业协会。工信部主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；指导拟订高技术产业中涉及信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等。

中国半导体行业协会是由中国半导体领域从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学等单位、专家及其他相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织，下设6个分支机构，其主要职能有：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府行业主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；开展信息咨询工作，对行业与市场情况进行调查研究与分析预测；开展经济技术交流和学术交流活动；开展国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等。

2、行业相关法律法规及政策

半导体硅片行业是国家重点支持及鼓励发展的战略新兴产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业，近年来，各相关部委相继出台了多项政策以支持行业发展，主要内容如下：

时间

颁发部门

相关政策

主要内容

2020 年 12 月

财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部

《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》

国家鼓励的集成电路线宽小于 28 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税；国家鼓励的集成电路线宽小于 65 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税；国家鼓励的集成电路线宽小于 130 纳米（含），且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

2020 年 7 月

国务院

《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》

国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件由工业和信息化部会同相关部门制定。

2020 年 5 月

财政部、税务总局

《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》

依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

2019 年 11 月

工信部

《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》

包括半导体、集成电路、钢铁材料、铜材、铝材料、钛材、先进化工材料、膜材料以及先进无机非金属材料等。

2019 年 10 月

国家发改委

《产业结构调整指导目录（2019 年本）》

半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，依然属于国家鼓励类产业之一。

2019 年 3 月

国务院

《2019 年政府工作报告》

促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。坚持包容审慎监管，支持新业态新模式发展，促进平台经济、共享经济健康成长。加快在各行各业各领域推进“互联网+”。

2018 年 11 月

国家统计局

《战略性新兴产业分类（2018 年版）》

新材料行业-3.4 先进无机非金属材料-3.4.3 人工晶体制造-3.4.3.1 半导体晶体制造 6 英寸、8 英寸及以上单晶硅片，硅外延片。

2018 年 3 月

国务院

《2018 年政府工作报告》

加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区。大幅压减工业生产许可证，强化产品质量监管。全面开展质量提升行动，推进与国际先进水平对标达标，弘扬劳模精神和工匠精神，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，来一场中国制造的品质革命。

2017 年 9 月

国务院办公厅

《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》

提出发挥财政性资金带动作用，通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式，广泛吸纳各类社会资本，支持企业加大技术改造力度，加大对集成电路等关键领域和薄弱环节重点项目的投入。

2017 年 4 月

科技部

《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》

面向 45-28-14 纳米集成电路工艺，重点研发 300 毫米硅片、深紫外光刻胶、抛光材料、超高纯电子气体、溅射靶材等关键材料产品，通过大生产线应用考核认证并实现规模化销售；研发相关超高纯原材料产品，构建材料应用工艺开发平台，支撑关键材料产业技术创新生态体系建设与发展。

2017 年 3 月

国务院

《2017 年政府工作报告》

加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、新能源、人工智

能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

2017 年 1 月

工信部

《新材料产业发展指南》

加强大尺寸硅材料、大尺寸碳化硅单晶、高纯金属及合金溅射靶材生产技术研发，加快高纯特种电子气体研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约。

2016 年 11 月

国务院

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。支持提高代工企业及第三方 IP 核企业的服务水平，支持设计企业与制造企业协同创新，推动重点环节提高产业集中度。推动半导体显示产业链协同创新。

2016 年 5 月

国务院

《国家创新驱动发展战略纲要》

推动产业技术创新，创造发展新优势。加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障。

2016 年 3 月

全国人大

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

支持战略性新兴产业发展，大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化；培育一批战略性新兴产业；设立国家战略性新兴产业发展基金，充分发挥新兴产业创业投资引导基金作用，重点支持新兴

产业领域初创期创新型企业。培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点。

2016 年 1 月

科技部财政部国家税务总局

《高新技术企业认定管理办法》

国家重点支持的高新技术领域：半导体新材料制备与应用技术中，大尺寸硅单晶生长、晶片抛光片、SOI 片及 SiGe/Si 外延片制备加工技术；大型 MOCVD 关键配套材料、硅衬底外延和 OLED 照明新材料制备技术；大尺寸砷化镓衬底、抛光及外延片、GaAs/Si 材料制备技术等。

2014 年 6 月

国务院

《国家集成电路产业发展推进纲要》

突破集成电路关键装备和材料。加强集成电路装备、材料与工艺结合，研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，开发光刻胶、大尺寸硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增强产业配套能力。

2012年2月

工信部

《电子信息制造业“十二五”发展规划》

集成电路产品满足国内市场需求近30%，芯片制造业规模生产技术达到12英寸、32/28纳米工艺确定为创新目标，提出持续支持12英寸先进工艺制造线和8英寸/6英寸特色工艺制造线的技术升级和产能扩充。加快45纳米及以下制造工艺技术的研发与应用，加强标准工艺、特色工艺模块开发和IP核的开发。资料来源：观研天下整理（WW）

观研报告网发布的《2021年中国半导体硅片市场分析报告-产业运营现状与发展潜力评估》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2017-2021年中国半导体硅片行业发展概述

第一节 半导体硅片行业发展情况概述

一、半导体硅片行业相关定义

二、半导体硅片行业基本情况介绍

三、半导体硅片行业发展特点分析

四、半导体硅片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售模式

五、半导体硅片行业需求主体分析

第二节 中国半导体硅片行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、半导体硅片行业产业链条分析

三、产业链运行机制

(1) 沟通协调机制

(2) 风险分配机制

(3) 竞争协调机制

四、中国半导体硅片行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国半导体硅片行业生命周期分析

一、半导体硅片行业生命周期理论概述

二、半导体硅片行业所属的生命周期分析

第四节 半导体硅片行业经济指标分析

一、半导体硅片行业的赢利性分析

二、半导体硅片行业的经济周期分析

三、半导体硅片行业附加值的提升空间分析

第五节 中国半导体硅片行业进入壁垒分析

一、半导体硅片行业资金壁垒分析

二、半导体硅片行业技术壁垒分析

三、半导体硅片行业人才壁垒分析

四、半导体硅片行业品牌壁垒分析

五、半导体硅片行业其他壁垒分析

第二章 2017-2021年全球半导体硅片行业市场发展现状分析

第一节 全球半导体硅片行业发展历程回顾

第二节 全球半导体硅片行业市场区域分布情况

第三节 亚洲半导体硅片行业地区市场分析

一、亚洲半导体硅片行业市场现状分析

二、亚洲半导体硅片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲半导体硅片行业市场前景分析

第四节 北美半导体硅片行业地区市场分析

一、北美半导体硅片行业市场现状分析

二、北美半导体硅片行业市场规模与市场需求分析

三、北美半导体硅片行业市场前景分析

第五节 欧洲半导体硅片行业地区市场分析

一、欧洲半导体硅片行业市场现状分析

二、欧洲半导体硅片行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲半导体硅片行业市场前景分析

第六节 2021-2026年世界半导体硅片行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球半导体硅片行业市场规模预测

第三章 中国半导体硅片产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品半导体硅片总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国半导体硅片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国半导体硅片产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国半导体硅片行业运行情况

第一节 中国半导体硅片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

1、行业技术发展现状

2、行业技术专利情况

3、技术发展趋势分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国半导体硅片行业市场规模分析

第三节 中国半导体硅片行业供应情况分析

第四节 中国半导体硅片行业需求情况分析

第五节 我国半导体硅片行业进出口形势分析

1、进口形势分析

2、出口形势分析

3、进出口价格对比分析

第六节、我国半导体硅片行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第七节 中国半导体硅片行业供需平衡分析

第八节 中国半导体硅片行业发展趋势分析

第五章 中国半导体硅片所属行业运行数据监测

第一节 中国半导体硅片所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国半导体硅片所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国半导体硅片所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第六章 2017-2021年中国半导体硅片市场格局分析

第一节 中国半导体硅片行业竞争现状分析

- 一、中国半导体硅片行业竞争情况分析
- 二、中国半导体硅片行业主要品牌分析

第二节 中国半导体硅片行业集中度分析

- 一、中国半导体硅片行业市场集中度影响因素分析
- 二、中国半导体硅片行业市场集中度分析

第三节 中国半导体硅片行业存在的问题

第四节 中国半导体硅片行业解决问题的策略分析

第五节 中国半导体硅片行业钻石模型分析

- 一、生产要素
- 二、需求条件
- 三、支援与相关产业
- 四、企业战略、结构与竞争状态
- 五、政府的作用

第七章 2017-2021年中国半导体硅片行业需求特点与动态分析

第一节 中国半导体硅片行业消费市场动态情况

第二节 中国半导体硅片行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节 半导体硅片行业成本结构分析

第四节 半导体硅片行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、渠道因素
- 四、其他因素

第五节 中国半导体硅片行业价格现状分析

第六节 中国半导体硅片行业平均价格走势预测

- 一、中国半导体硅片行业价格影响因素
- 二、中国半导体硅片行业平均价格走势预测
- 三、中国半导体硅片行业平均价格增速预测

第八章 2017-2021年中国半导体硅片行业区域市场现状分析

第一节 中国半导体硅片行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区半导体硅片市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区半导体硅片市场规模分析
- 四、华东地区半导体硅片市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区半导体硅片市场规模分析
- 四、华中地区半导体硅片市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区半导体硅片市场规模分析
- 四、华南地区半导体硅片市场规模预测

第九章 2017-2021年中国半导体硅片行业竞争情况

第一节 中国半导体硅片行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

第二节 中国半导体硅片行业SCP分析

- 一、理论介绍
- 二、SCP范式
- 三、SCP分析框架

第三节 中国半导体硅片行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境

- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 半导体硅片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析
- 四、公司优劣势分析

第二节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国半导体硅片行业发展前景分析与预测

第一节 中国半导体硅片行业未来发展前景分析

- 一、半导体硅片行业国内投资环境分析
- 二、中国半导体硅片行业市场机会分析
- 三、中国半导体硅片行业投资增速预测

第二节 中国半导体硅片行业未来发展趋势预测

第三节 中国半导体硅片行业市场发展预测

- 一、中国半导体硅片行业市场规模预测
- 二、中国半导体硅片行业市场规模增速预测
- 三、中国半导体硅片行业产值规模预测
- 四、中国半导体硅片行业产值增速预测
- 五、中国半导体硅片行业供需情况预测

第四节 中国半导体硅片行业盈利走势预测

- 一、中国半导体硅片行业毛利润同比增速预测
- 二、中国半导体硅片行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国半导体硅片行业投资风险与营销分析

第一节 半导体硅片行业投资风险分析

- 一、半导体硅片行业政策风险分析
- 二、半导体硅片行业技术风险分析
- 三、半导体硅片行业竞争风险分析
- 四、半导体硅片行业其他风险分析

第二节 半导体硅片行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国半导体硅片行业发展战略及规划建议

第一节 中国半导体硅片行业品牌战略分析

- 一、半导体硅片企业品牌的重要性
- 二、半导体硅片企业实施品牌战略的意义
- 三、半导体硅片企业品牌的现状分析
- 四、半导体硅片企业的品牌战略
- 五、半导体硅片品牌战略管理的策略

第二节 中国半导体硅片行业市场重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国半导体硅片行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国半导体硅片行业发展策略及投资建议

第一节 中国半导体硅片行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

第二节 中国半导体硅片行业营销渠道策略

- 一、半导体硅片行业渠道选择策略
- 二、半导体硅片行业营销策略

第三节 中国半导体硅片行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国半导体硅片行业重点投资区域分析
- 二、中国半导体硅片行业重点投资产品分析

图表详见报告正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/545390545390.html>